



(51) 国際特許分類6 H01L 23/48	A1	(11) 国際公開番号 WO99/60626 (43) 国際公開日 1999年11月25日(25.11.99)
(21) 国際出願番号 PCT/JP99/02357 (22) 国際出願日 1999年4月30日(30.04.99) (30) 優先権データ 特願平10/138691 1998年5月20日(20.05.98) JP 特願平10/138692 1998年5月20日(20.05.98) JP 特願平10/246023 1998年8月31日(31.08.98) JP (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) ローム株式会社(ROHM CO., LTD.)(JP/JP) 〒615-8585 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 Kyoto, (JP) (72) 発明者；および (75) 発明者／出願人 (米国についてのみ) 佐野正志(SANO, Masashi)(JP/JP) 鈴木伸明(SUZUKI, Nobuaki)(JP/JP) 鈴木慎一(SUZUKI, Shinichi)(JP/JP) 〒615-8585 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内 Kyoto, (JP)		(74) 代理人 吉田 稔, 外(YOSHIDA, Minoru et al.) 〒543-0014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町2-32-1301 Osaka, (JP) (81) 指定国 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE) 添付公開書類 国際調査報告書
(54)Title: SEMICONDUCTOR DEVICE (54)発明の名称 半導体装置 <div style="text-align: center;"> </div> (57) Abstract A semiconductor device (X1) comprises a semiconductor chip (3), a first lead (1) connected with one pole of the semiconductor chip (3), a second lead (2) connected with the other pole of the semiconductor chip (3), and a resin package (4) enclosing the semiconductor chip (3), the inner terminal (10) of the first lead (1), and the inner terminal (20) of the second lead (2). The resin package (4) comprises first to fourth sides (41-44), an upper surface (47), and a bottom (45). The first and second leads (1, 2) each include at least one bent external terminal (11, 21) extending along the first side (41) and bottom (45) of the resin package (4).		